

ASmPT enabling the
digital world



DEK Galaxy

先进封装和
高精度SMT装配

打造晶圆、基板及PCB层面的卓越性能与极致灵活性

您是否正在寻找一款集高精度与强大功能于一身的印刷机？DEK Galaxy无疑是您的理想之选。这款锡膏印刷机提供出色的性能与前所未有的灵活性，能够轻松应对多样化的产品制造需求：无论是进行精准的晶圆凸块印刷，还是面向未来装配需求的SMT预装备，或是在焊球直径低至0.2毫米的晶圆或基板上进行DirEKt Ball Attach(植球)工艺，DEK Galaxy都能精准掌控，确保在不同制造需求之间无缝切换。

DEK Galaxy集成了ASMPT的成熟技术，如采用线性马达，确保实现最高速度、精度和可靠性。该款印刷机提供了诸多选件，包括单独对位的治具系统，该系统支持在一个印刷周期内同时定位并印刷多块基板，还有专为基板和晶圆处理而设计的JEDEC晶圆盘和载具等传输选件。在进行高密度装配时，Grid-Lok®和定制工具能提供卓越的基板支撑能力。

DEK Galaxy提供兼容SMEMA的接口，能够与晶圆装载和基板助焊等DEK解决方案轻松集成，还能够与球栅阵列回流焊系统或贴片平台等后道设备集成。无论是作为独立运行的尖端设备，还是作为ASMPT专家精心打造的“一站式”工艺解决方案的一部分，DEK Galaxy均展现出无可匹敌的性能优势，堪称业界性能之典范。



DEK GALAXY 创新



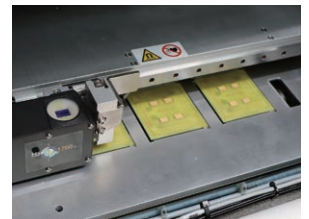
全新推出DEK Typhoon 高速钢网底部清洁系统

这种钢网底部清洁系统展现出无与伦比的灵活性与卓越的速度优势，通过灵活的可更换插入腔室长度设计，能够针对每一种工艺需求及钢网特性，提供最佳的清洁性能。



物料管理

DEK锡膏厚度监测和DEK锡膏自动添加系统（管装或罐装）组合应用，可实现对锡膏量的自动控制。



DEK多板定位系统 (MASS)

能同步光学定位多个基板——这是单板高效、高精度印刷领域的一项重大技术飞跃。

DEK GALAXY展现 无可比拟的竞争优势



无与伦比的精度

系统对准精度: $\pm 12.5 \mu\text{m}$
>2.0 cmk ($\pm 6 \text{ sigma}$)时
湿印精度: $\pm 17.5 \mu\text{m}$
>2.0 cpk ($\pm 6 \text{ Sigma}$)时



高产能输出

CCT (核心周期时间)
达到7秒



卓越的印刷质量

提高直通良率



快速新品导入(NPI)

Instinctiv V9软件集成了快速设置功能，
可迅速进行首次印刷，操作更便捷，
同时具有防错与纠错功能。



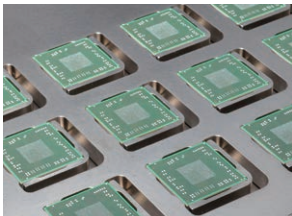
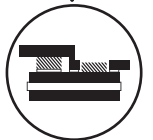
创新的单板治具

支持在一个印刷周期内
同时单独定位和
处理多块基板



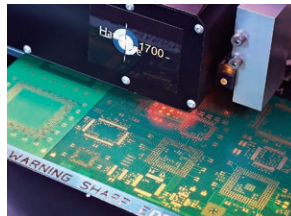
3D立体钢网印刷

功率电子封装领域采用
银膏进行3D立体钢网印刷



DEK虚拟面板治具 (VPT)

DEK虚拟面板治具(VPT)支持
印刷机在单个周期内处理多
个独立基板。



DEK HawkEye®

DEK HawkEye®系统支持在印
刷机内部快速验证印刷效果。

DEK Galaxy印刷机平台

设备类型	DEK Galaxy
标准配置	描述
系统对准精度*	> 2.0 cmk @ ±12.5 µm, (±6 Sigma)
湿印精度	> 2.0 cpk @ ±17.5 µm, (±6 Sigma)
核心周期时间(CCT)	7秒
最大印刷面积	600 mm (X) × 508.5 mm (Y)
控制器	通过CAN BUS总线网络进行移动控制
用户界面	触摸屏、键盘和轨迹球、Instinctiv V9软件、Windows 10物联网企业版
相机	HawkEye® 1700数码相机，采用IEEE 1394接口，多通道LED照明，FOV为11.3 mm × 8.7 mm，检测窗口75 mm²
轴驱动	精度为1 µm的高精度线性马达和编码器
刮刀压力控制	软件控制、马达驱动并集成闭环控制电路
模板定位	自动装载系统，带有锡膏滴漏盘
钢网定位	通过制动器驱动X、Y、和θ
钢网底部清洁	DEK Typhoon高速清洁装置，具有完全可编程的湿、干及真空擦拭模式，提供多种规格的清洁头长度(300 mm、400 mm、460 mm、515 mm)
最小基板尺寸	50 mm (X) × 40.5 mm (Y)
最大基板尺寸	620 mm (X)** × 508.5 mm (Y)
机器尺寸(近似值)	2060 mm × 1500 mm × 1570 mm (81.1" × 59" × 61.8")(长 × 宽 × 高)
压缩空气供应	根据ISO 8573.1标准质量等级2.3.3，气压：5 - 8 bar 标准耗气量：5升/分钟，气压：5 - 8 bar。最大耗气量：226升/分钟，气压：6 bar
重量	带包装重量(视具体配置而定)： 840千克 不带包装重量(视具体配置而定)： 680千克
选件	
DEK锡膏管理	自动添加锡膏和自动监测锡膏高度
ProFlow	选件
闭环控制连接SPI系统	利用ProDEK进行先进锡膏控制
半导体选件	SEMI S2/S8、SECS GEM、VPT治具、DirEKT植球、MASS

* 遵循实际生产过程中常见的工艺变量条件，对机器精度与重复精度进行测量。

** 长板选项



先进装配系统有限公司
上海市东育路227弄3号前滩世贸中心二期C栋3层 | 电话: +86 21 58873030 | E-mail:smt-solutions.cn@asmpt.com

asmpt.com | smt.asmpt.com

14/07-2026版 | 保留所有权利 | 订购号：A22-ASMPT-A345-ZH | 中国印刷 | ©ASMPT GmbH & Co.KG

本手册中的所有信息和插图均以“概不保证”的方式提供，不含任何明确或隐含的担保，包括但不限于对质量满意、适用于特定用途和/或正确性的隐含担保。

本手册的内容仅供参考，不构成建议，如有更改，恕不另行通知。ASMPT在法律允许的最大范围内，对本手册中包含的内容、细节、规格或信息的正确性、准确性、充分性、实用性、及时性、可靠性或其他方面的使用不作任何保证或声明。请联系ASMPT以获取最新信息。仅在达成协议的情况下，特定性能特性和/或功能才具有法律效力。

所有产品名称均为ASMPT或其他供应商的品牌或者商标。第三方使用需经所有者授权。